

# ハロゲンフリーソルダペースト

## S3X48-M500-2 Sn Ag3.0 Cu0.5

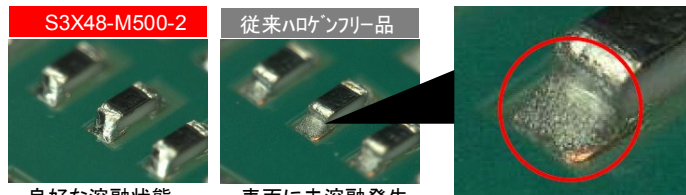
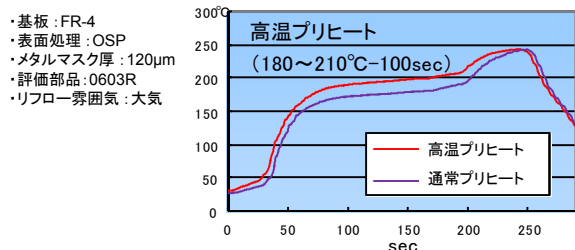


- ハロゲン入り製品と同等の濡れ特性
- 継ぎ足し連続使用可能、廃棄量を大幅低減
- トータルバランスに優れた製品性能



### ◆ 高温プリヒートにも対応、優れたはんだ溶融性

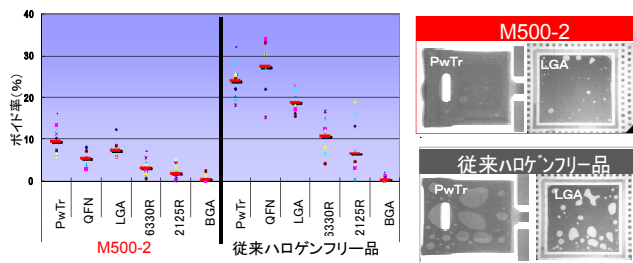
■ 高温プリヒート時の溶融状態 (従来ハロゲンフリー品との比較)



良好な溶融状態 表面に未溶融発生  
フラックス耐熱性を向上、高温プリヒートでも完全な溶融性が得られます。

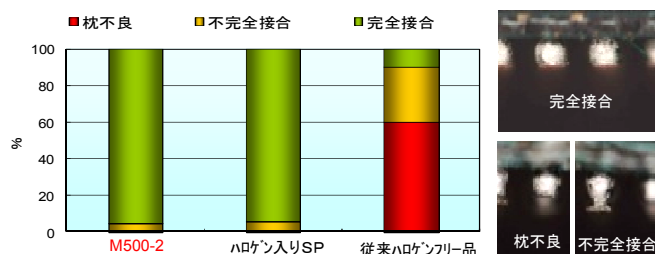
### ◆ 低ボイド化を実現

■ 各部品でのボイド率



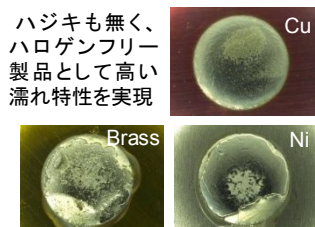
### ◆ 優れた耐枕不良特性

■ リフローしたソルダペースト上に劣化したBGAパッケージを搭載。再度リフローを行い、接合状態を確認。



### ◆ 良好な濡れ特性

■ ディウェッティング試験



### ◆ 作業性・信頼性を両立

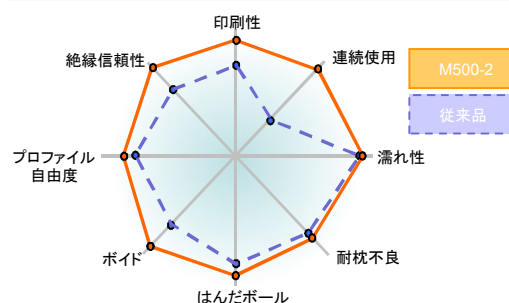
■ ハロゲン含有量 (ppm)

試験規格: IPC-TM650 2.3.28.1  
: BS EN14582

	IPC	BS
Cl	ND	ND
Br	ND	ND

ND: 不検出

### ◆ すべての特性で安定した性能



### ◆ 製品物性表

製品名	S3X48-M500-2	S3X58-M500-2
合金組成 (%)	Sn Ag3.0 Cu0.5	
融点 (°C)	217-219	
粉末粒度 (μm)	20-45	20-38
粘度 (Pa.s)	220	
フラックス含有量 (%)	11.5	

### ◆ ハロゲンフリー製品ラインナップ

S3X48・58-M650-3	ICT対応
S3X70-M500	微細粉タイプ (10~25 μm)
SB6N58-M500SI	高耐久In合金
T4AB58・TB48-M742	低融点SnBi合金
S3X-60NH	低飛散タイプや入りはんだ
JS-EU-31	低残渣タイプポストフラックス